



技術と対話で未来をつくる

Technology & Tai-wa for Tomorrow

Corporate Profile

KOKUSAI ELECTRIC Way

私たちには、技術を常に追求します。

さまざまな領域で技術を磨き、それらを融合することにより、イノベーションを生み出します。

私たちには、対話を常に大切にします。

誠実に対話を続け、課題の本質と真摯に向き合うことにより、最良の解決策を導き出します。

私たちには、技術と対話で多様なニーズにお応えし、創造と革新が生まれる未来を支え続けます。

2022年に企業理念を一新

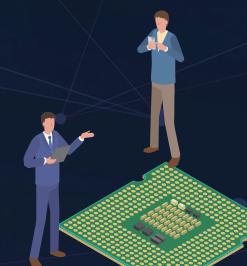
世界中で描かれるさまざまな夢が、創造と革新の連鎖によって一つ一つ叶えられていくことで未来はつながっていく。

私たちには、そんな世の中のベストパートナーでありたいと考えており、これからも技術と対話で未来を支えていく決意を込め、企業理念を「KOKUSAI ELECTRIC Way」として一新しました。

制定にあたっては、従業員でワーキンググループをつくり、私たちの存在意義や果たすべき使命、大切にしている価値観などについて見つめ直すことからはじめ、多くの議論を重ねました。

私たちの技術と対話は、成長を続けていく上で不变のDNAであり、今後も大切にすべき精神として次世代にも継承していきます。

夢を未来につなぐ ベストパートナー



技術と対話で未来をつくる
KOKUSAI ELECTRICグループは、
技術と対話で創造と革新が
生まれる未来を支えます。



私たちの技術

- ・技術を洗練する
- ・技術で挑戦する
- ・技術を創出する
- ・技術で魅了する



私たちの対話

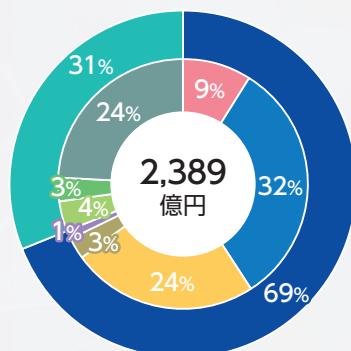
- ・先端技術との対話
- ・社会課題との対話
- ・自然環境との対話
- ・自分自身との対話

At a Glance

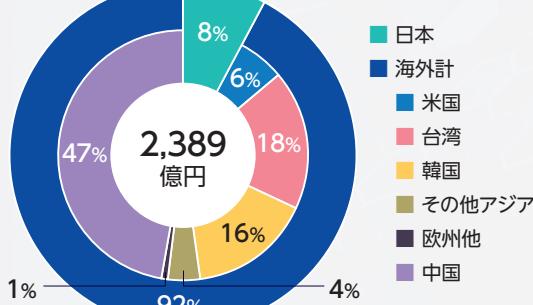
当社グループは、半導体製造の数ある工程の中で、半導体デバイスの性能を左右する成膜プロセス、トリートメント(膜質改善)プロセス、酸化・拡散・アニールプロセスを軸に事業を展開しています。これらのプロセス技術に対応する当社グループの半導体製造装置は世界中の半導体デバイスメーカーから高い評価をいただき、世界トップクラスのシェアを有しています。

財務概要

2025年3月期ビジネス／ アプリケーション別売上収益(連結)



2025年3月期地域別(仕向地別)売上収益(連結)



事業内容(装置ビジネス)

当社グループは半導体デバイスの製造工程における「前工程」の中で、主にデバイスの性能を左右する成膜プロセス装置と枚葉トリートメントプロセス装置を開発しています。成膜プロセスは、ウェーハに回路の素材となる薄膜などを形成する工程で、トリートメントプロセスは成膜プロセスで形成した薄膜の膜質を改善させる工程です。今後さらにデバイスの複雑化・微細化・三次元化が進むことで、当社グループの成膜技術やトリートメント技術がますます必要になります。



バッチ成膜装置 Batch ALD^{※1}対応成膜装置

世界シェア No.1 (2024年)^{※2}

- 数十枚以上のウェーハを一括処理するバッチ成膜装置のうちALD技術に対応する装置で、高難易度成膜と高生産性の両立が可能。
- デバイスの複雑化に伴ってニーズが拡大。



トリートメント装置 Plasma Gate Modification Tools

世界シェア No.1 (2024年)^{※3}

- 成膜後にプラズマや加熱により膜質を改善させることを目的とした装置で、独自のプラズマ技術により優れた等方性とステップカバレッジを実現。
- デバイスの複雑化に伴ってニーズが拡大。
- 低温環境における膜質改善のニーズが拡大。



事業内容(サービスビジネス)

当社が製造・販売する半導体製造装置のライフサイクル全般にわたって、部品販売、保守サービス、有償修理、装置の移設・改造のアフターサービスを提供しています。また、グループ会社の販売ネットワークを活用してウェーハサイズ200mm以下のレガシー装置(新品・中古)販売にも注力しており、“Design for Service Business”的コンセプトでさらなる高付加価値サービスの提供をめざします。



※1 当社グループでは、複数のガスをサイクリックに供給する工程を伴い、原子層レベルで成膜する手法を「ALD」と呼んでいます。 ※2 出典:TechInsights Inc. "TI_ALD Tools_YEARLY" (April 2025)

※3 出典:Gartner®. Market Share: Semiconductor Wafer Fab Equipment, Worldwide, 2024. Bob Johnson et al. Published 21 April 2025. Revenue share from Shipments basis of Plasma Gate Modification Tools in CY2024. GARTNERは、Gartner Inc.または関連会社の米国および他の国における登録商標およびサービスマークであり、同社の許可に基づいて使用しています。All rights reserved. Gartnerは、Gartnerリサーチの発行物に掲載された特定のベンダー、製品またはサービスを推奨するものではありません。また、最高のランクまたはその他の評価を得たベンダーのみを選択するようにテクノロジーユーザーに助言するものではありません。Gartnerリサーチの発行物は、Gartnerリサーチの見解を表したものであり、実績を表現したものではありません。Gartnerは、明示または黙示を問わず、本リサーチの商品性や特定目的への適合性を含め、一切の責任を負うものではありません。本書に記載するGartnerのコンテンツ(以下「Gartnerコンテンツ」)は、Gartnerシンジケート・サブスクリプション・サービスの一部としてGartner, Inc.(以下「Gartner」)が発行したりサーチ・オフィスまたは見解を表すものであり、実績を述べているものではありません。Gartnerコンテンツの内容はいずれも、そのコンテンツが発行された当時の内容であり、本書が発行された日の内容ではありません。また、Gartnerコンテンツに記載されている見解は予告なく変更されることがあります。

グローバルネットワーク

国内

2社

海外

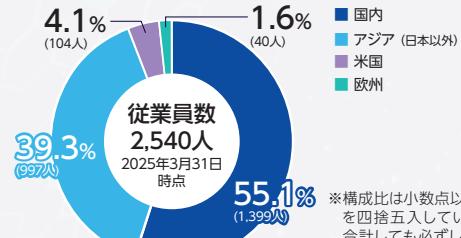
6社

海外従業員割合(連結) *

44.9%

※2025年3月31日時点の当社従業員数は2,540人です。そのうち、海外従業員割合は44.9%となっています。

地域別従業員割合(連結) *



主な開発、設計、生産拠点

富山事業所

立山連峰を望む富山市八尾町。専用のクリーンルーム内で次世代プロセスに対応した半導体製造装置等の開発、設計、生産を行い、世界の大手ユーザーからの最先端の高度な製品ニーズに対応しています。

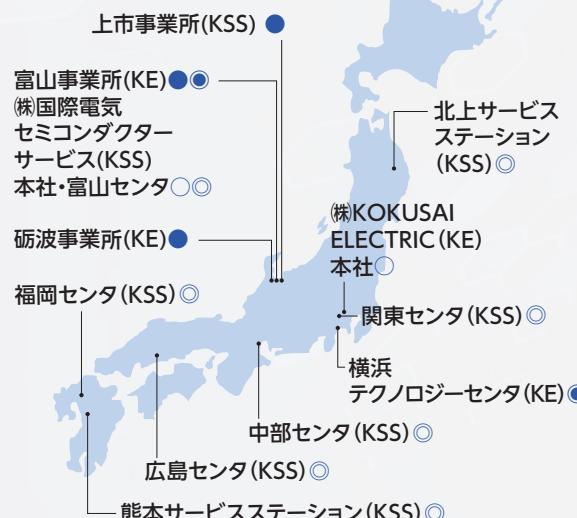


砺波事業所

2024年9月に竣工した新たな生産拠点。IoT、DXなどの先端ソリューションを導入することでスマートファクトリー化を推進。富山県砺波市に位置し、既存の富山事業所にも近く、サプライチェーンやエンジニアの共通化も効率的に行えます。



国内拠点



○本社、販売機能 ●生産機能 ○サービス機能 ○研究開発機能

技術と対話で“課題”と向き合い 半導体分野の発展とサステナブルな未来に貢献する

世界中の皆様の明るい未来のために、課題・問題を解決に導く

KOKUSAI ELECTRICグループは、半導体製造装置の開発・設計・製造や、部品販売・保守サービスなどを生業としています。当社グループが半導体製造装置の開発に取り組みはじめたのは、1950年代。以来、技術は飛躍的に進歩し、業界の構造も著しく変化してきました。私が国際電気株式会社(当時)に入社した1986年は、日本の半導体が世界を席巻し、「電子立国」という言葉にも現実味があった時代です。その後、社長に就任するまでの約40年間で、業界を取り巻く国際的な勢力図も変化し、KOKUSAI ELECTRICグループの事業の中心も海外へと移っていました。こうして、設計、製造、営業、経営企画、海外駐在、グループ会社の経営など、幅広い業務に携わってきたことが、私のキャリアの特徴です。変化の中で培った経験を生かし、柔軟な視点で新たな時代の半導体製造装置業界をリードすることが、トップとしての使命だと考えています。

その指針となるのが、コーポレートスローガンである「技術と対話で未来をつくる(Technology & Tai-wa for Tomorrow)」です。シンプルな言葉ですが、私はそこに企業活動の本質が表れていると感じています。「技術」とは、すなわち“課題や問題を解決に導く力”であり、「対話」とは“課題や問題を発見する力”と解釈することで、当社グループが培ってきた強みと、めざすべき未来とが結びつきます。では、「未来」とは“誰にとっての”未来なのでしょうか。この問いに対して、真っ先に思い浮かぶのはステークホルダーの皆様です。株主・投資家の皆様、ビジネスパートナーや地域社会、そして従業員やその家族。私はさらに広い範囲の人々も含まれると考えています。当社グループの半導体製造装置によって、お客様が半導体デバイスを製造し、それがさまざまな電子機器に組み込まれることで、人々の生活が豊かになる。そのような世界を実現するため、「課題解決力」「課題発見力」「世界の皆様の明るい未来」をキーワードに、社内外でビジョンを共有していきます。

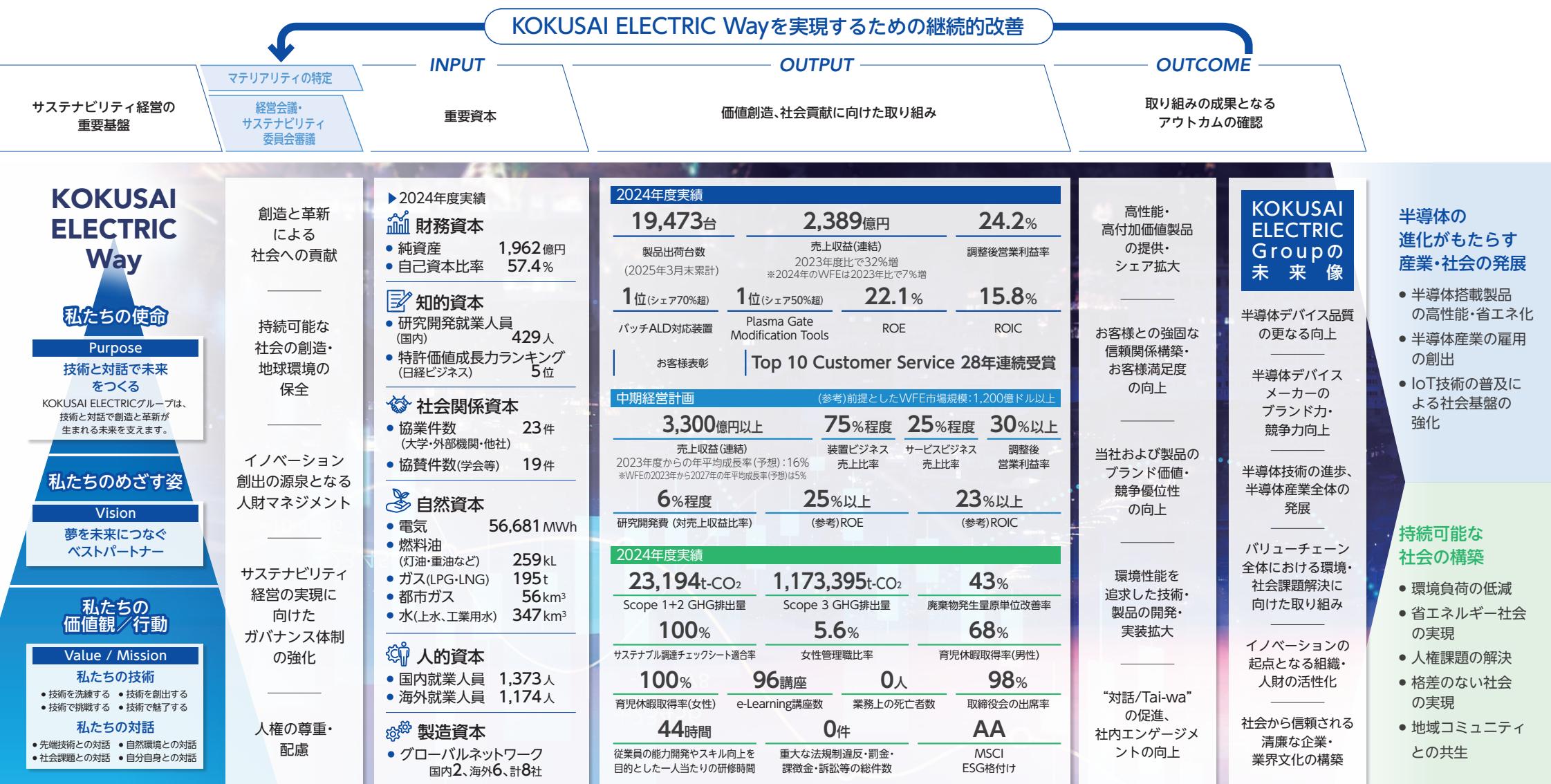
代表取締役 社長執行役員

塙田 和徳



価値創造プロセス >>

当社グループは、サステナビリティ経営基盤のもと、解決すべきマテリアリティを起点に、経営資本を有効に活用した事業とESGの取り組みの両側面での活動を通じ、産業・社会の発展や持続可能な社会の構築に貢献していく価値創造プロセスを描き、その実現に向け高品質・高性能な製品および付加価値の高いサービスの提供、持続可能な社会の構築に努めています。



当社グループのCSR・サステナビリティ経営の考え方

当社グループは、事業活動を通じて社会の信頼・期待に応えていくことが企業の社会的責任であると考えています。

私たちのサステナビリティ経営は、この社会的責任を強く自覚した上で、事業活動とESG(環境・社会課題の解決、ガバナンスの強化)の両側面から経済価値および環境・社会価値を追求することにより、SDGsの達成に寄与するとともに、持続可能な社会の実現と当社グループの持続的な発展の両立をめざすものです。

当社グループでは、企業理念、マテリアリティ(重要取り組み課題)、専門会議体の運営、国際的イニシアティブへの参画などの活動基盤により、サステナビリティ経営を推進しています。

これらの活動の実践状況は、本報告書やウェブサイトなどで公表し、ステークホルダーの皆様と当社グループのサステナビリティ経営について広く対話する材料とします。

▶ SDGsの達成に寄与・持続可能な社会の実現 ◀



社会的責任(CSR)

事業活動を通じて
社会の信頼・期待に応えていく

当社グループの企業価値を追求

環境 (環境価値の追求)	事業 (経済価値の追求)	社会 (社会価値の追求)
-----------------	-----------------	-----------------

サステナビリティ・ガバナンス
企業価値を棄損させることなく
持続的な発展へと結びつける

▶ 当社グループの持続的な発展 ◀



企業価値向上

ブランド価値
(環境価値・社会価値)

経済価値



KOKUSAI ELECTRICグループの理念体系

当社グループは、KOKUSAI ELECTRIC Wayのもと、SDGs達成への貢献と当社グループの持続的な発展の両立をめざすため、重点的に取り組む課題としてマテリアリティを特定し、事業活動とESG(環境・社会課題の解決、ガバナンスの強化)の両側面から、持続可能な社会の実現と当社グループの持続的な発展の両立をめざしています。

現在、当社は5つの主要なマテリアリティを特定しており、これらの課題を解決するために中長期事業戦略および中期経営計画を策定しています。これらの計画は、各年度の運営方針や各部門の予算計画に具体的な取り組みやKPIとして盛り込んでいます。最終的には、これらの方針が一人ひとりの業務に反映され、全社的なサステナビリティ経営の実現へとつなげています。

KOKUSAI ELECTRIC Way <コーポレートスローガン>

技術と対話で未来をつくる / **Technology & Tai-wa[®] for Tomorrow**
– KOKUSAI ELECTRICグループは、技術と対話で創造と革新が生まれる未来を支えます –

マテリアリティ (重要取り組み課題)

中長期事業戦略 / 中期経営計画

年度運営方針

各部門の運営方針・業務予算、具体的なアクションアイテム/KPI

B (ビジネス) の側面

予算会議、事業戦略会議等で審議・フォローアップ

E/S/Gの側面

サステナビリティ委員会で審議・フォローアップ

中期経営計画

当社グループは、今後予想される市場環境やお客様のニーズに適切に対応し、さらなる高収益体质へと転換する施策を推進するため、中長期的な事業戦略と中期目標を設定しています。なお、中期目標については、財務担当役員メッセージ [P.18](#) をご参照ください。

事業環境の展望

半導体製造装置市場に大きく影響する半導体デバイス市場の規模は、2016年の約3,500億ドルに対し、2022年には約6,100億ドルと1.7倍へ拡大しており、2023年から2029年まで年平均成長率10.9%で成長することが予想されています^{*1}。半導体デバイス市場拡大の背景には、スマートフォンやパソコン等の電子機器の需要拡大や、AI、IoT、DX等の拡がりによるデータセンターの拡充やグリーントランジスフォーメーションへの投資等の産業向けの需要拡大、主要国による産業支援策があります。足元の世界経済は、緩やかな成長基調にあったものの、依然として先行きに対する不透明な状況が続いている、スマートフォンやパソコン等の電子機器の需要回復が遅れています。しかしながら半導体デバイス市場では、生成AIの普及等を背景に先端DRAMに対する需要が増加しており、2025年以降需要が本格回復し、さらに2029年に向けて技術革新の継続・加速により再び成長基調へ進むものと期待しています。

半導体製造装置市場は2016年の約370億ドルに対し、2022年には約980億ドルと2.6倍以上へ拡大しており、2023年から2029年まで年平均成長率7.6%で成長することが予想されています^{*2}。足元では先端DRAM、先端ノード向けLogic/Foundry向けの設備投資が加速しており、NANDも2025年に入り回復の兆しが見られ、今後半導体デバイスの需要回復に伴って半導体製造装置の需要も回復するものと見ています。中長期的には、半導体デバイスの微細化、構造の複雑化、三次元化が進む中で、難易度の高い成膜と高い生産性を両立することのできる半導体製造装置へのニーズが高まると考えています。

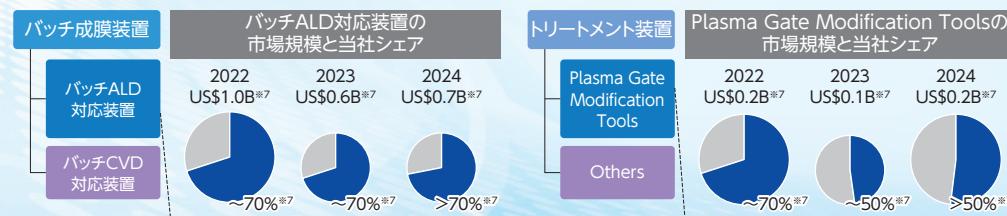
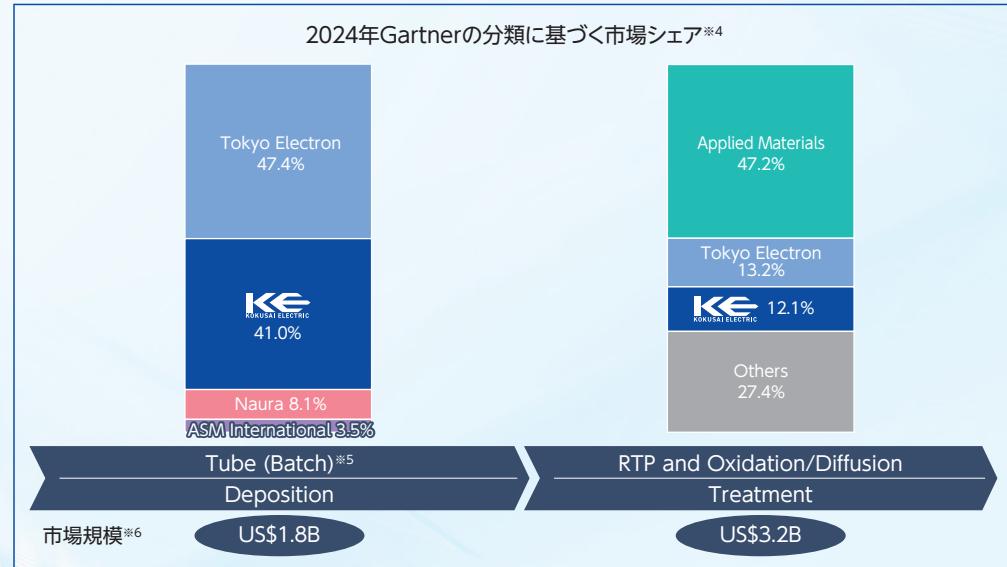
半導体デバイス／半導体製造装置の世界市場規模^{*1、*2}（単位：10億ドル）

	2016年	2022年	2023年	2029年（予想）
半導体デバイスの世界市場規模	351.8	613.9	559.1	1,041.4
半導体製造装置の世界市場規模	37.0	97.7	99.0	153.7

*1:Techinsights Inc. 2025-06-14 - Semiconductor Forecast Q2 2025 Update *2:Techinsights Inc. IC MANUFACTURING EQUIPMENT MARKET HISTORY AND FORECAST (2019 - 2029) *3:当社グループでは、複数のガスをサイクリックに供給する工程を伴い、原子層レベルで成膜する手法を「ALD」と呼んでいます。 *4:出典: Gartner®. Market Share: Semiconductor Wafer Fab Equipment Worldwide, 2024. Bob Johnson et al. Published 21 April 2025. 図はガートナーリサーチに基づき、Kokusai Electricが作成。ここに記載のある数値は、Kokusai Electricにより算出されたものです。Treatment(トリートメント装置): RTP and Oxidation/Diffusion. GARTNERは、Gartner Inc.または関連会社の米国およびその他の国における登録商標およびサービスマークであり、同社の許可に基づいて使用しています。All rights reserved. Gartnerは、Gartnerリサーチの発行物に掲載された特許のペンダント、製品またはサービスを推奨するものではありません。また、最高のレーティングまたはその他の評価を得たペンダントのみを選択するようにテクノロジーユーザーに助言するものではありません。Gartnerリサーチの発行物は、Gartnerリサーチの見解を表したものであり、事実を表現したものではありません。Gartnerは、明示または默示を問わず、本リサーチの商品性や特定目的への適合性を含め、一切の責任を負うものではありません。本書に記載するGartnerのコンテンツ（以下「Gartnerコンテンツ」といいます）は、Gartnerシンジケート・サブスクリプション・サービスの一部としてGartner, Inc.（以下「Gartner」）が発行したリサーチ・オピニオンまたは見解を表すものであり、事実を述べているものではありません。Gartnerコンテンツの内容はいずれも、そのコンテンツが発行された当時の内容であり、本書が発行された日の内容ではありません。また、Gartnerコンテンツに記載されている見解は予告なく変更されることがあります。 *5:GartnerによるWFEセグメントにおける「Tube CVD」を「Tube (Batch)」と定義（当社にて算出） *6:Gartnerによるカテゴリーの合計値 *7:公開情報・当社売上高に基づき当社推定

マーケットシェアの推移

半導体デバイスの微細化、複雑化、三次元化が進む中、需要が拡大するバッチALD^{*3}対応装置およびPlasma Gate Modification Toolsの領域で世界シェア1位（2024年）を獲得しました。^{*4} 今後も高付加価値製品の提供によりシェア拡大と売上収益の拡大、収益性の向上をめざします。



中長期的な経営方針

当社グループは、半導体製造プロセスの前工程における「成膜」工程に注力しており、バッチ成膜装置、枚葉トリートメント（膜質改善）装置で世界トップクラスのシェアを有しています。近年、半導体デバイスの微細化や構造の複雑化、三次元化によってウェーハの表面が複雑な形状になり、高品質な薄膜等を形成するにはより高度な技術が必要とされています。これに対して当社グループは、難易度の高い成膜と高い生産性を両立するバッチALD^{※1}技術や、高い生産性を維持しつつ形成された薄膜の膜質を改善するトリートメント技術を生かした高付加価値製品の販売拡大や研究開発に注力し、事業拡大を図っています。

また、装置のライフサイクル全体にわたって、メンテナンスや修理、部品供給、移設・改造等お客様のニーズに合わせたサービスの拡充を図るとともに、今後の需要拡大に対応するための生産体制および開発体制の拡充、DXを活用した生産効率向上にも注力してまいります。

ESGの取り組みでは、①創造と革新による社会への貢献、②持続可能な社会の創造・地球環境の保全、③イノベーション創出の源泉となる人財（人材）マネジメント、④サステナビリティ経営の実現に向けたガバナンス体制の強化、⑤人権の尊重・配慮の5つのマテリアリティに基づき、課題解決に向けた活動を推進していきます。

※1:当社グループでは、複数のガスをサイクリックに供給する工程を伴い、原子層レベルで成膜する手法を「ALD」と呼んでいます。

具体的な施策

当社グループを取り巻く事業環境は、スマートフォンやパソコン等の電子機器の需要回復が遅れる中、半導体デバイス市場では生成AIの普及等を背景に先端DRAMに対する需要が増加しています。Logic/Foundryは、一部のデバイスマーカーに投資抑制が見られるものの、全体として先端ノード向けの設備投資が加速しています。NANDも年度終盤に回復の兆しが見られ、今後回復が進むものと期待できます。中長期的には、スマートフォンやパソコン等の電子機器の需要拡大に加え、AI、IoT、DX等の拡がりによるデータセンターの拡充やグリーントランസフォーメーションへの投資等により、半導体関連市場は大きな成長が見込まれています。

こうした状況をふまえ、当社グループは、上記の経営方針に基づき、以下の重点施策を推進していきます。

- 1 イノベーションによる高付加価値製品の継続的な創出とお客様のニーズを的確に捉えた開発体制の強化
- 2 さらなる業績拡大のためのお客様への提案力の強化
- 3 サービスビジネスのさらなる拡大
- 4 グループ一体運営をはじめとする高効率経営の推進
- 5 多様な人財が活躍できる職場環境づくり

中期的な事業戦略

3つの戦略に重点的に取り組むことでWFE (Wafer Fab Equipment:半導体製造装置市場) を上回る事業成長の実現をめざします。

- 1 NAND、DRAM、Logic/Foundryの各アプリケーションの複雑化・三次元化に合わせて、当社のバッチALD対応装置、トリートメントプロセス装置の販売を拡大
- 2 成熟ノード向けのバッチ成膜装置や成長著しいSiCパワーデバイス向け装置の販売推進による「成膜」領域での収益基盤の拡大
- 3 製品のライフサイクル全体でお客様のニーズに対応するサービスを提供し、高収益なサービスビジネスの事業拡大

短期・中長期のカタリストと当社グループのロードマップ



※1 出典: TechInsights Inc. IC MANUFACTURING EQUIPMENT MARKET HISTORY AND FORECAST (2019 - 2029) (March 2025)

事業戦略

近年、半導体デバイス構造の多層化、微細化、三次元化によってウェーハの表面が複雑な形状になり、高品質な薄膜を形成するにはより高度な成膜技術が必要とされています。また、複雑な形状での高品質な成膜には時間がかかるため、生産性の課題が顕在化しています。これに対して当社グループは、難易度の高い成膜と高い生産性を両立するバッチALD^{※1}技術や、高い生産性を維持しつつ形成された薄膜の膜質を改善するトリートメント（膜質改善）技術を生かした高付加価値製品の販売拡大や研究開発に注力し、事業拡大を図っています。また、装置のライフサイクル全体にわたって、メンテナンスや修理、部品販売、移設・改造などお客様のニーズに合わせたアフターサービスの拡充を図るとともに、今後の需要拡大に対応するための生産体制および開発体制の拡充、DXを活用した生産効率向上にも注力しています。

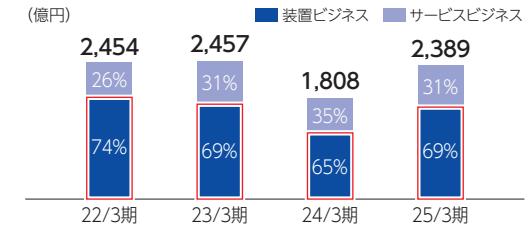
装置ビジネスの概要

事業内容

装置ビジネスは、半導体製造の数ある工程の中で、半導体デバイスの性能を左右する成膜プロセス、トリートメントプロセス、酸化・拡散・アニールプロセスで用いられる装置の製造および販売を行っています。当社グループの成膜プロセス装置、トリートメントプロセス装置は、世界中の半導体デバイスメーカーから高い評価をいただき、世界トップクラスのシェアを有しています。

強み

- 高い生産性と高難易度成膜を両立するバッチALD技術
- 独自のプラズマ源により高い生産性で優れた等方性、ステップカバレッジを実現するトリートメント技術
- 長年の実績に基づくお客様との強固なリレーションシップ



成膜プロセス装置

成膜プロセス装置は、ウェーハの電子回路形成における回路素材となるポリシリコン膜や絶縁膜等の薄膜を形成する装置で、「ALD」「LP-CVD」などに適応しています。この成膜工程は、ウェーハ上の回路形成において重要な役割を担うことから、各装置に高度な技術と信頼性の高い製品提供が不可欠となります。当社グループの主力製品であるバッチ成膜装置は、世界中の半導体デバイスメーカーから高く評価されており、中でもバッチALD対応装置は世界トップクラスのシェアを有しています。

ミニバッチ成膜プロセス装置 「TSURUGI-C²® 鏡[®]」



- 次世代の高難易度成膜への対応に向けた性能と高生産性を備えた装置
- 最新のバッチALD技術など薄膜形成プロセスに対応

ラージバッチ成膜プロセス装置 「AdvancedAce[®]-II」



- 高難易度成膜に加えてラージバッチによる処理枚数の増加と処理時間の短縮を実現した装置
- バッチALD技術、バッチCVD技術、酸化技術、拡散技術、アニール技術などに対応

トリートメントプロセス装置／酸化・拡散・アニールプロセス装置

トリートメントプロセス装置は、成膜後にプラズマや加熱により膜中の不純物の除去や粒子を安定させることを目的とした装置です。また、酸化・拡散・アニールプロセス装置は、熱酸化膜を形成するプロセスや、成膜後に加熱して膜中の結晶サイズを揃えるプロセス（アニール）、成膜後に注入した不純物を加熱して均一に拡散するプロセスに適応しています。近年、半導体デバイスの微細化、複雑化に伴ってトリートメント技術に対する需要が拡大しており、枚葉トリートメントプロセス装置は世界トップクラスのシェアを有しています。

枚葉トリートメントプロセス装置 「MARORA[®]」



- 成膜後にプラズマや加熱により膜質を改善させることを目的とした装置
- 複雑な半導体形状に対して、高い生産性と品質でのトリートメントが可能

枚葉アニールプロセス装置 「TANDUO[®]」

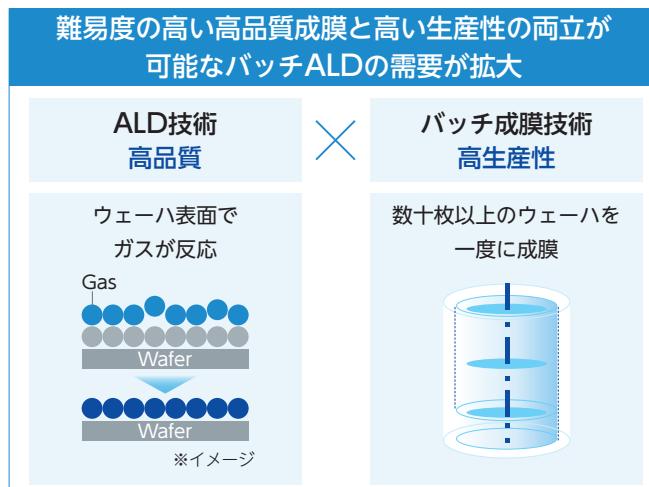
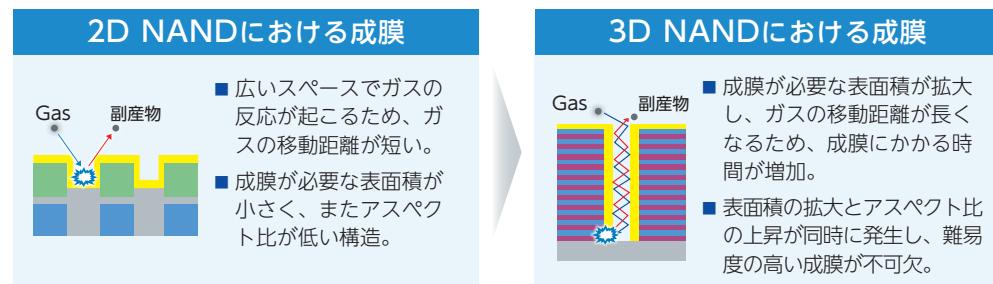


- 成膜後に加熱により膜質を改善させることを目的とした装置
- 低温でのアニールが可能

| 当社グループの強み

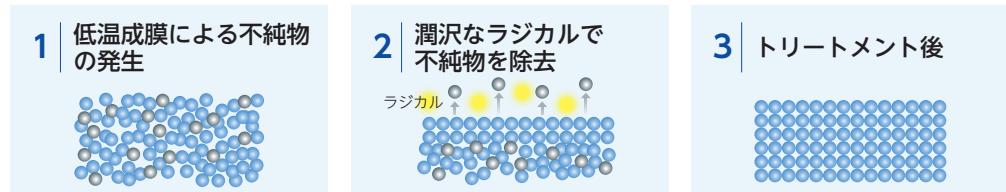
バッチALD^{*1}技術

ALD技術は、高品質な薄膜をステップカバレッジ良く形成することが可能な難易度の高い成膜技術で、半導体デバイスの進化とともにニーズが高まっています。このALD技術は、複数のガスをサイクリックに供給し、成膜を行うため、成膜に時間がかかり生産性に課題がありました。これに対して、一度に数十枚以上のウェーハへの成膜を可能とするバッチ成膜技術の生産性の高さが有効な解決策となります。高品質な成膜を実現するALD技術と、数十枚以上のウェーハを一度に成膜するバッチ成膜技術を組み合わせた当社グループのバッチALD技術は、高生産性と高難易度な成膜を両立する論理的なソリューションです。



トリートメント(膜質改善)技術

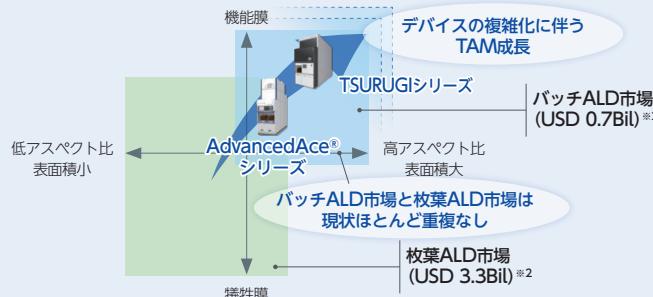
トリートメント技術とは、成膜後にプラズマや熱を加えることにより膜中の不純物を除去し、粒子を安定させることで膜質を改善させる技術です。半導体デバイスの微細化・複雑化に伴い低温環境での成膜需要が高まっており、トリートメント技術は低温環境で膜質改善を可能にするソリューションとしても需要が拡大しています。当社グループのトリートメントプロセス装置は、独自のプラズマ方式が生み出す潤沢なラジカルにより、等方性とステップカバレッジに優れた膜質改善を、高い生産性で実現するソリューションです。



TOPICS バッチALD対応成膜装置への需要拡大

半導体デバイスの多層化・微細化・三次元化が進展するにつれて、高アスペクト比かつ大きな表面積への成膜が求められるため、複雑な半導体デバイス構造に対する成膜の難易度は高まり、必要とされる時間はより一層長くなることから生産性は悪化します。

この課題を解決するのが、バッチALD対応成膜装置です。ステップカバレッジに優れた成膜を実現するALD技術と、一度に数十枚以上のウェーハを一括処理するバッチ技術を組み合わせたバッチALD技術は、高難易度成膜と高生産性の両立を可能とすることから、バッチALD対応成膜装置に対する需要は今後より一層拡大することが期待されています。



*1 当社グループでは、複数のガスをサイクリックに供給する工程を伴い、原子層レベルで成膜する手法を「ALD」と呼んでいます。

*2 公開情報・当社売上収益に基づき当社推定

サービスビジネスの概要

■ 事業内容

サービスビジネスは、当社グループが製造・販売する半導体製造装置において部品販売・保守サービスをはじめとするアフターサービスの提供を行っています。また、装置の移設・改造やウェーハサイズ200mm以下のレガシー装置(新規・中古)の販売も手掛けられています。

半導体設備投資サイクルの変動を受けにくく、かつ消耗品の販売等リカーリングな収益が発生するサービスビジネスは、安定的かつ高マージンな収益が期待されます。今後もDesign for Service Business^{※1}のコンセプトのもと高付加価値サービスの提供をめざします。

※1 製品開発段階でサービス事業において重要な部分を特定し、特許やデザイン権、特別な当社仕様などの偽造を防ぐためのデバイスを事前に作成することを目的とするもの。

パワーデバイス向けビジネス

サービスビジネスには、150mmや200mm装置の販売も含まれており、その中でもパワーデバイス向けの装置が高い成長を実現しています。足元では中国を除く世界各国市場でパワーデバイス向けの設備投資が停滞していますが、当社製品は操作・メンテナンスのしやすさ、スペアパーツの共通化、省エネヒーターによる優れた環境性能などが受け入れられ、堅調な販売が続いています。お客様と共同して評価を進めてきた高温活性化アニールでも初PORを獲得しており、今後の市況回復に合わせた売上貢献が期待されます。

High-Temp Activation Anneal (新製品)

- 極めて高温にするための新たな加熱システムと150/200mmの共通プラットフォームを採用
- 2025年以降の量産開始を想定



■ 強み

- 市況変化に左右されないリカーリング
かつ安定的なビジネス
- 装置トラブルに迅速かつ的確に対応できるよう、お客様の拠点近くにサービス体制を構築



TOPICS 生産能力・開発能力の増強

2024年10月、富山県砺波市に新しい工場として砺波事業所を操業するとともに、既存の富山事業所では、製造機能の一部を砺波事業所にシフトし、開発機能を拡充しています。これらにより、2026年3月期の製造キャパシティは2021年3月期に比べて約2倍、開発キャパシティは1.5倍に拡大し、2031年3月期までの需要拡大に対応できる体制を構築しました。



名称	砺波事業所
所在地	富山県砺波市下中条
敷地面積	約40,000m ²
投資金額	約240億円
用途／建設目的	半導体製造装置の製造／生産能力の拡大と既存の富山事業所における研究開発体制の強化
名称	米国デモセンタ
所在地	アメリカ合衆国オレゴン州
敷地面積	約34,000m ²
投資金額	約200億円(予定)
用途／建設目的	半導体製造装置のデモ評価およびサービス

半導体デバイス市場は今後も拡大が予想されているだけでなく、最先端半導体デバイス構造の複雑化、三次元化、微細化の進展により、半導体デバイスマーケターから当社グループに対してデモ評価等を通じた開発支援の要請が増加しています。

当社グループは、韓国の当社グループ会社にデモ評価エリアを拡張するなど、お客様の要請に応じた開発支援の取り組みを強化してきましたが、その一環として米国オレゴン州に米国デモセンタの新設を決定しました(2026年9月竣工予定)。

これまで富山事業所で行っていた米国半導体デバイスマーケター向けのデモ評価が、評価用ウェーハや人員の日米間での移動がなく迅速に完了できるだけでなく、現地でのサポート体制の強化によりお客様の課題を正確に把握することでお客様の研究開発のより綿密なサポートが可能となります。なお、米国デモセンターは今後の需要動向に応じて拡張することを想定しており、お客様の開発支援体制およびサポート体制のさらなる強化をめざします。

また、2025年4月に、次世代半導体関連の要素技術の研究開発強化に向けて、神奈川県横浜市に横浜テクノロジーセンタを開所しました。成膜プロセスをはじめとする前工程で培った技術やノウハウをシリコンインターポーラー等の中工程などに活用することで、新たな事業領域の創出を図ります。

環境・社会課題の解決に向けた取り組みの重要性や注目度が高まり続ける中、当社では、SDGsをはじめとする国内外の最新動向を踏まえ、実効的なコーポレート・ガバナンスと企業の持続可能な成長を実現するための「グローバル・サステナビリティ・ガバナンス」の構築に向け、めざす姿と中長期的なロードマップを描き、全社的な取り組みを推進しています。

各種の取り組みにおいては、共通して「KOKUSAI ELECTRICらしさ」を重視し、当社グループの強みや果たすべき使命に基づくサステナビリティ経営の実践、企業価値の向上をめざしています。



5年間の主要財務データ

主要項目	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期
売上収益(百万円)	178,023	245,425	245,721	180,838	238,933
売上総利益(百万円)	75,951	107,069	100,805	74,965	101,743
売上総利益率(%)	42.7	43.6	41.0	41.5	42.6
営業利益(百万円)	60,037	70,652	56,064	30,745	51,320
営業利益率(%)	33.7	28.8	22.8	17.0	21.5
税引前利益(百万円)	50,504	69,264	55,895	29,757	50,789
税引前利益率(%)	28.4	28.2	22.7	16.5	21.3
親会社の所有者に帰属する当期利益(百万円)	33,043	51,339	40,305	22,374	36,004
(参考)調整後営業利益(百万円)	52,413	79,421	64,251	37,839	57,753
(参考)調整後当期利益(百万円)	31,903	55,566	45,985	27,296	42,303
資本合計(百万円)	64,943	119,519	160,881	187,388	196,168
資産合計(百万円)	273,769	356,532	373,539	375,433	341,512
有利子負債(百万円)	125,760	123,191	99,206	93,018	60,184
ネット・キャッシュ(百万円)	△85,721	△14,792	6,847	△399	△15,429
研究開発費(百万円)	7,552	9,885	12,425	12,683	15,604
設備投資額(百万円)	2,562	3,322	6,568	20,454	20,348
減価償却費および償却費(百万円)	9,609	10,004	10,304	10,945	12,625
営業キャッシュ・フロー(百万円)	51,127	73,615	29,993	2,942	38,477
投資キャッシュ・フロー(百万円)	△3,312	△3,348	△7,825	△11,950	△27,706
財務キャッシュ・フロー(百万円)	△48,317	△3,508	△25,113	△6,312	△58,106
フリー・キャッシュ・フロー(百万円)	47,815	70,267	22,168	△9,008	10,771
1株当たり親会社所有者帰属持分(円)	281.87	518.75	698.26	804.49	842.12
基本的1株当たり当期利益(円)	143.42	222.83	174.93	96.82	154.60
1株当たり配当金(円)	—	—	—	11.00	37.00
配当性向(%)	—	—	—	11.4	20.4
研究開発比率(%)	4.2	4.0	5.1	7.0	6.5
自己資本比率(%)	23.7	33.5	43.1	49.9	57.4
(参考)自己資本利益率(ROE)(%)	47.3	60.2	32.8	15.7	22.1
(参考)投下資本利益率(ROIC)(%)	17.1	25.6	18.3	10.1	15.8

* 当社グループは国際会計基準(IFRS)に基づいて連結財務諸表を作成しています。

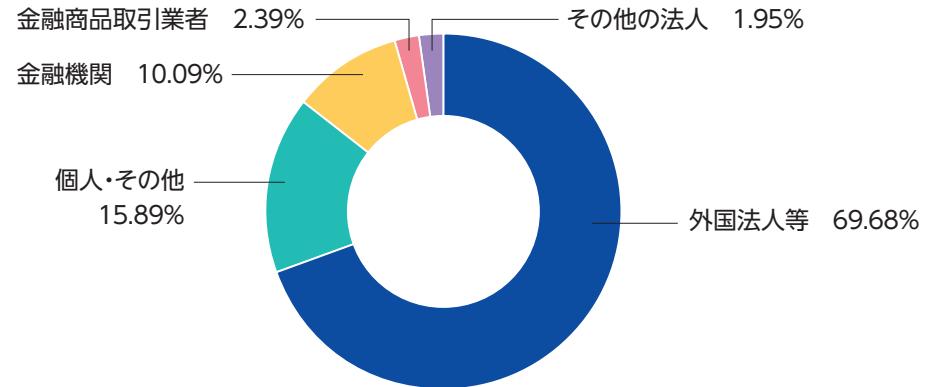
* 1株当たり配当金および配当性向については、上場後のみを記載しています。2024年3月期の1株当たり配当金につきましては、上場時期が下半期であることを踏まえて半期分の金額としています。

会社情報／株式の状況

会社概要／株式関連情報 (2025年3月31日現在)

社名	株式会社KOKUSAI ELECTRIC
設立	2017年2月2日
本社所在地	〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町三丁目4番地 oak神田鍛冶町5階
資本金	140億86百万円
従業員数	連結:2,540人／単体:1,148人
上場市場	東京証券取引所 プライム市場
証券コード	6525
発行可能株式総数	900,000,000株
発行済株式総数	238,002,985株
事業年度	4月1日～翌年3月31日
定時株主総会	毎年6月
株主確定基準日	3月31日
期末配当金受領株主確定日	3月31日
中間配当金受領株主確定日	9月30日
単元株式数	100株

所有者別株式分布状況 (2025年3月31日現在)



大株主の状況 (2025年3月31日現在)

株主名	保有数(千株)	持株比率(%)
KKR HKE INVESTMENT L.P.	42,505	18.25
BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC	35,080	15.06
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001	17,673	7.59
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	16,331	7.01
KKR HKE Investment L.P. G.P. KKR HKE Investment Limited	12,187	5.23
Qatar Holding LLC	11,520	4.95
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	4,730	2.03
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234	3,168	1.36
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)	2,313	0.99
HSBC - FUND SERVICES CLIENTS A/C 500	1,942	0.83

技術と対話で未来をつくる



株式会社 KOKUSAI ELECTRIC

<https://www.kokusai-electric.com/>

発行月 2025年12月